

FineXT 6003

大面积多芯片组装

高速和高精度的生产

- » 贴装精度3微米
- » 适用于呈放晶圆和面板的超大贴片区域



自动贴装精度校准

自动基片传输系统可整合到量产的生产线

多芯片贴装能力

多晶圆装载能力

模块化机器平台允许在整个使用期内进行现场改造

全自动芯片吸头管理

全自动物料管理

功能

多种键合技术 (胶粘、焊接、热压、超声)	一台设备实现多种工艺，实现真正的灵活性
单个程序即可实现多种键合工艺	实现新技术方法的真正灵活性
3色LED照明	不同材料的优秀对比度值，以实现最佳的能见度和识别
数据/多媒体记录和报告生成功能	全面的工艺文件和工艺参数的可追溯性分析
通过触摸屏实现全进程访问和简易可视化编程	工艺顺序的快速整合，直观呈现工艺流程
同步控制所有相关工艺参数	最优的过程控制和再现性
通过TCP (MES, SHEMA)实现工艺和材料的可追溯性	集中实现对工艺和生产线控制的全面追溯，保证最高的成品率
可选的工艺模块实现个性化配置	根据应用需求量身定制的设备解决方案
集成摩擦功能	减少空洞率并改善表面浸润条件，以增加热接触和优化焊接效果
支持各种物料装载形式 (wafer, waffle pack, Gel-Pak®)	全自动处理来自多种不同载盘的物料

效益

技术和方法

- » 烧结
- » 热压焊接
- » 焊接/共晶焊接
- » 胶粘贴片

工艺

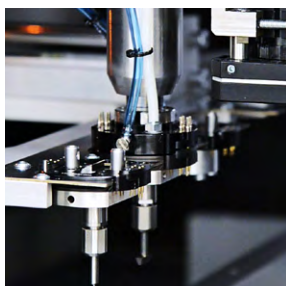
- » 倒装芯片键合 (正面朝下)
- » 高精度芯片键合 (正面朝上)
- » 晶圆级封装 (FOWLP, W2W, C2W)
- » 2.5D及3D集成电路封装 (堆叠)
- » 面板级封装 (FOPLP)
- » 多芯片组装 (MCM, MCP)
- » 芯片到玻璃基板贴装 (CoG)
- » 芯片到柔性基板贴装 (CoF)
- » 玻璃粘合
- » 芯片到基板贴装 (CoB)
- » 嵌入式芯片封装

应用

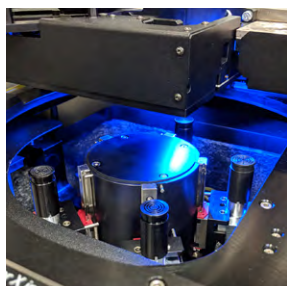
- » 光模块组装 (TOSA/ROSA)
- » 大功率激光模块组装
- » 激光巴条组装
- » 激光二极管组装
- » 机械组装
- » 射频/高频模块组装
- » VCSEL/PD (阵列) 组装
- » 微型光学器件组装

工艺模块 / 增强功能

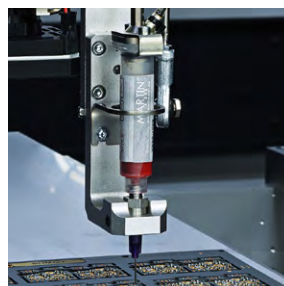
- » 自动蘸胶模块
- » 自动吸头更换模块
- » 芯片加热模块
- » 芯片陈放台
- » 带传送的蓝膜取片模块
- » 芯片翻转模块
- » 点胶模块
- » 灵活的芯片陈放台
- » 甲酸模块
- » 基板传送模块
- » 高度感知 (激光测距)
- » I/O升降系统
- » I/O面板装卸系统
- » 标识码识别系统
- » 自动蘸胶模块
- » 工艺气体模块
- » 工艺气体选择
- » 带有料盒升降功能的可编程晶圆更换器
- » 基板加热模块
- » 基板固定
- » 紫外固化模块
- » 晶圆加热模块
- » 自动芯片晶圆更换
- » 晶圆固定工作台



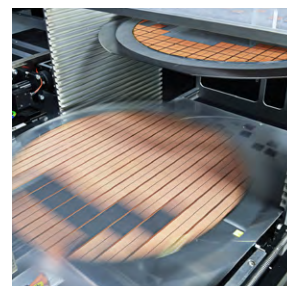
自动吸头更换模块



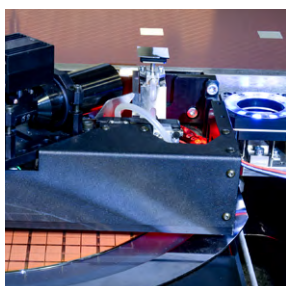
带传送的蓝膜取片模块



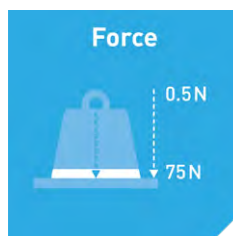
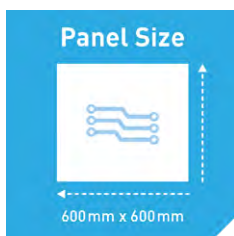
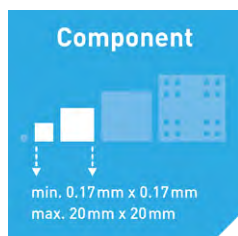
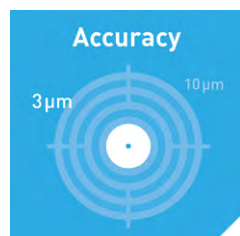
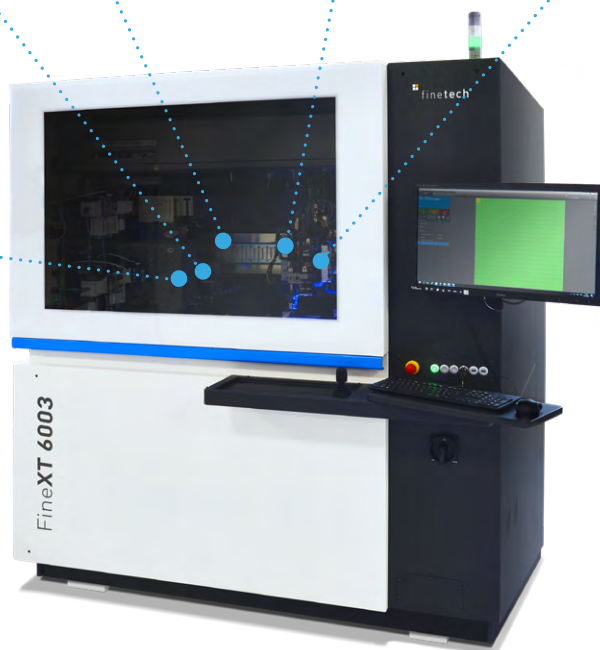
点胶模块



带有料盒升降功能的可编程晶圆更换器



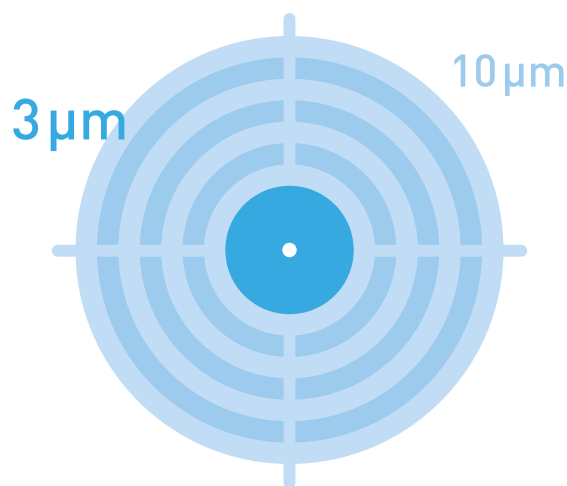
芯片翻转模块



我们如何验证精度

关于封装行业中的组装系统，也就是所谓的贴片机，其贴装精度是分类的关键因素。然而，通常对这个精度是什么含义，又是如何进行验证不是十分明确。因此，Finetech 采用了一种透视可验证的方法来证明我们设备的贴片精度。这篇技术论文列举了影响设备精度的相关因素，如何让客户自己对Finetech设备的精度进行验证，此方法也同时适用于其它供应商的同类设备。

[在此下载本文:](#)



模块化的回报

由于各种工艺和功能模块可供选择，FINEPLACER® 支持十分广泛的应用领域。在一开始，这种灵活性的设计完全支持根据当前需求量身定制。此外，系统在其整个使用年限内可以适应新的任务，这是我们设备理念的一个组成部分。各种模块可以方便地组合或交换，这样大大增加了系统的灵活性，并保障了长期投资。

客户反馈

"We use a Finetech die bonder for complex flip chip, sensor and opto-electronics applications, along with co-development of new assembly processes for leading semiconductor customers. The bonder has allowed us to help customers develop, optimize, verify and enhance many state-of-the-art technologies."



Dhiraj Bora
CEO & President, Silitronics